

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他（<u>电话会议</u>）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 9 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理李大林先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司目前整体稼动率情况和后续展望？ 成熟产品方面，2025 年 Q1 存在春节假期影响和季节性波动，Q2 稼动率相对 Q1 环比进一步上升，产能趋于饱满，Q3、Q4 的稼动率依然会保持环比增长的趋势；晶圆级封装稼动率持续爬坡中；2.5D 封装还处于量产前的客户验证阶段。 2、价格变动趋势？ 目前封测行业价格处于相对稳定的状态。 3、台湾两家大客户毛利情况？ 整体毛利率符合预期，主要原因是订单量大，生产效率较高，不会受到改机、做 DOE 等因素的影响，因此动态毛利率相对不错。 4、下半年毛利趋势预测？ 单季度可能会受到转固节奏的影响而波动，但整体看来毛利率将会保持持续上升趋势。产品结构方面，公司先进封装产品占比持续提高，将会继续对毛利率产生

	正向影响；稼动率方面，公司晶圆级封装产能持续爬坡，随着这部分稼动率的提升，未来会持续对毛利率起到正向提升作用。 5、2.5D 封装正式量产贡献收入大概需要多久？ 公司 2.5D 封装产线于 2024 年四季度通线，目前正在和相关客户做产品验证。但由于 2.5D 封装产品工艺复杂，验证周期较长，实现稳定量产需要一定时间。 6、不同客户的芯片方案要求是一样的吗？ 公司根据客户需求提供定制化的封装技术解决方案，新客户导入前公司会跟客户交流方案要求，并且量产前会进行产品方案 DOE 验证。 7、先进制程客户导入周期？ 先进制程芯片价格昂贵，验证过程比较严谨，因此客户导入周期较长，大致在一年以上。 8、封测厂和第三方测试厂分工的区别？ 两者商业模式上有所区别，封测厂的测试业务是其封测业务的一部分，商业逻辑是封装驱动测试提供大 turnkey 方案，通常情况下测试产能会低于封装产能，第三方测试厂的测试业务是一项独立专业的服务，旨在不同维度验证和评估芯片的功能，两者是竞争合作关系。公司会在自身测试产能饱和或客户有特殊测试要求的情况下将部分测试业务外包给第三方测试厂。 9、研发支出及期间费用未来变动趋势？ 研发支出方面，由于公司专注于中高端先进封装，因此围绕先进封装领域，公司研发投入持续提升，研发费用率将会维持在 6%-7%左右的水平。期间费用方面，今年上半年的管理费用率从去年同期的 8%下降到 6.61%，财务费用率从去年同期的 6.07%下降到 5.15%，随着规模效应进一步显现，未来还有较大降低空间。
--	--

	10、现有客户应用领域营收占比拆分？哪类客户 forecast 比较乐观？ 从应用领域来看，AIoT 占比接近 70%，PA 和安防各占比约为 10%，PA 整体营收占比略有下滑，运算和车规产品合计占比 10%左右，其中 AIoT 及车规产品增速较快，客户提供的 forecast 较为乐观。 11、公司车规领域主要做哪些产品？ 公司在车规领域主要做车载 CIS 及激光雷达、MCU 等产品。 12、目前海外客户营收占比？ 目前海外客户占比约为 25%，预计下半年还会持续提升。 13、Q3 营收增长预期？全年营收增长预期？ 公司预计 Q3 营收环比保持良好增长，整体收入表现良好。全年营收将保持增长趋势。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 19 日